

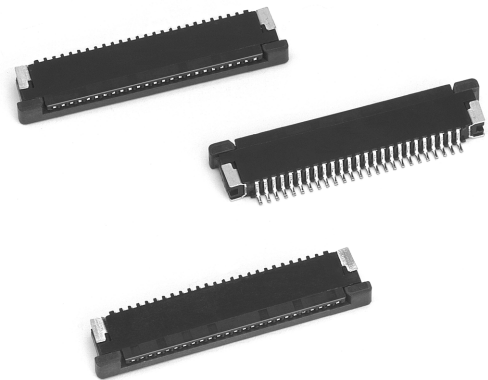
5531

ZIF-Stecker - SMT - RM 1,00 mm - horizontaler Eingang

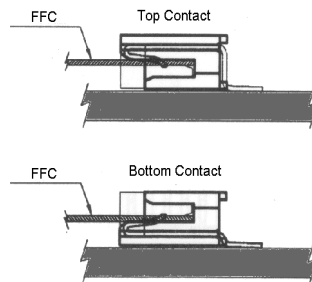
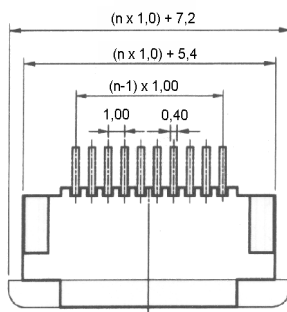
ZIF-Connector - SMT - Pitch 1,00 mm - Horizontal Entry

Technische Daten / Technical Data:

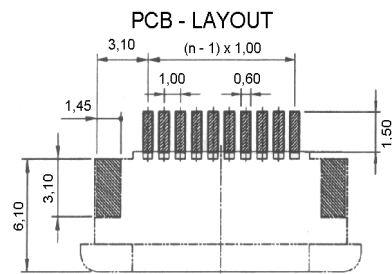
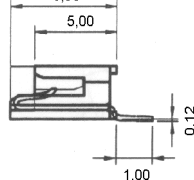
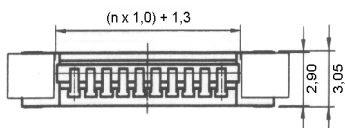
Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94V0
Insulator	Thermoplastic, rated UL94V0
Kontaktmaterial	Phosphorbronze
Contact Material	Phosphor Bronze
Kontaktfläche	Zinn über Nickel
Contact Surface	tin plated over nickel
Lötbarkeit	IEC512-12A
Solderability	IEC512-12A
Durchgangswiderstand	≤ 20 mOhm
Contact Resistance	≤ 20 mOhm
Isolationswiderstand	> 5x10 ⁸ Ohm
Insulation Resistance	> 5x10 ⁸ Ohm
Spannungsfestigkeit	500 V _{AC}
Test Voltage	500 V _{AC}
Nennspannung	60 V _{AC}
Current Voltage	60 V _{AC}
Nennstrom	0,5 A
Current Rating	0,5 A
Temperaturbereich	-40°C...+105°C
Temperature Range	-40°C...+105°C
Verarbeitung	Reflow-Lötverfahren; weitere Informationen in Kapitel T
Processing	Reflow-Soldering, further informations in chapter T



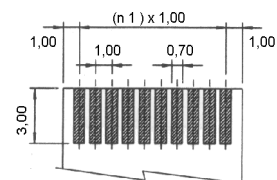
© W+P PRODUCTS



n = Anzahl Kontakte
n = No. of Contacts



Recommended Flexible Flat Cable (FFC)



Total Thickness of FFC: T=0,30 mm

Series	Contacts*	Type*	Packing*
5531	10 04-30-pol.	10 10 = Kontakt oben top contact 20 = Kontakt unten bottom contact	ST ST TR

Passendes Flex-Kabel siehe Seite L10.
Flexible Flat Cable see page L10.

(* Bestellbeispiel - Bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.
* Order example - To be replaced by your specifications.)

Lieferformen / Packing Options:

ST = verpackt in Stangen / packed in tubes
TR = Tape & Reel Verpackung / Tape & Reel Packing

TEL.: +49 5223 98507-0
FAX : +49 5223 98507-50

W+P PRODUCTS

E-MAIL: sales@wpro.com
INTERNET: www.wpro.com

Informationen zum Reflow-Lötverfahren

Reflow-Soldering Informations

Reflow-Lötverfahren Reflow-Soldering

Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Lötten im Reflowverfahren verarbeitet werden (Maximalwerte):

Profil Eigenschaft	Bleifreies Lötten
Durchschnitts-Ramp-Up Rate ($T_{s_{max}}$ to T_p)	3 °C / Sek. Max.
Vorheizen - Temperatur Min ($T_{s_{min}}$) - Temperatur Max ($T_{s_{max}}$) - Zeit ($t_{s_{min}}$ auf $t_{s_{max}}$)	150°C 200°C 60-180 Sekunden
Verbleiben oberhalb: - Temperatur (T_L) - Zeit (t_L)	217°C 60-150 Sekunden
Peak/Klassifizierung Temperatur (T_p)	260°C +/- 5°C
Zeit innerhalb von 5°C um die Peak-Temperatur (t_p)	20-40 Sekunden
Ramp-Down Rate	6°C / Sekunde max.
Zeit von 25°C bis zur Peak-Temperatur	8 Minuten max.

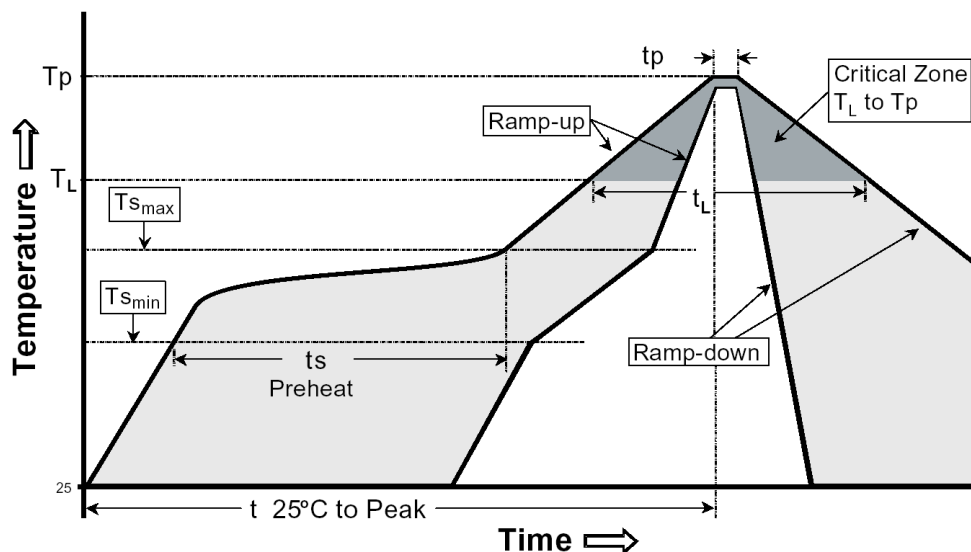
© W+P PRODUCTS

Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature-profile for leadfree reflow-soldering (maximum values):

Profile Feature	PB-Free assembly
Average Ramp-Up Rate ($T_{s_{max}}$ to T_p)	3 °C / second max.
Preheat - Temperature Min ($T_{s_{min}}$) - Temperature Max ($T_{s_{max}}$) - Time ($t_{s_{min}}$ to $t_{s_{max}}$)	150°C 200°C 60-180 seconds
Time maintained above: - Temperature (T_L) - Time (t_L)	217°C 60-150 seconds
Peak/Classification Temperature (T_p)	260°C +/- 5°C
Time within 5°C of actual Peak Temperature (t_p)	20-40 seconds
Ramp-Down Rate	6°C / second max.
Time 25°C to Peak Temperature	8 minutes max.

Empfohlenes Reflow-Lötprofil:

Recommended Reflow-Soldering profile:



T